

气派科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年工作回顾

（一）董事会尽责履职情况

2022 年公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十七次会议	2022 年 4 月 15 日	《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案》 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于公司变更会计政策的议案》

			《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十八次会议	2022 年 5 月 30 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于调整独立董事津贴的议案》 《关于全资子公司对外捐赠的议案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第一次会议	2022 年 6 月 16 日	《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》 《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 《关于制定<子公司管理制度>的议案》
4	第四届董事会第二次会议	2022 年 8 月 4 日	《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
5	第四届董事会第三次会议	2022 年 10 月 28 日	《关于 2022 年第三季度报告的议案》
6	第四届董事会第四次会议	2022 年 10 月 9 日	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 经营成果

2022 年，受国际经济环境的影响，集成电路行业出现周期性波动，集成电路终端消费下滑导致供需关系有所改变，产业链出现去库存的现象，消费市场不

景气，电子产品终端以手机、计算机为代表的终端产品需求疲软，因此，集成电路行业呈下行趋势，公司受行业景气度等影响，营收有较大幅度下降，叠加募投项目和自有资金扩产等原因，导致公司费用增加，使公司业绩大幅下降。报告期，公司营业收入 54,037.82 万元，同比下降 33.23%；归属上市公司股东的净利润为 -5,856.03 万元，同比下降 143.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-7,430.00 万元，同比下降 158.79%。

1.持续加大研发投入，提升核心技术

虽然公司 2022 年营业收入和净利润有所下降，但公司仍然对行业充满信心，在新技术和新产品的研发上持续加大投入。报告期，公司共获得 34 项专利授权，其中发明专利 9 项，实用新型 25 项；申请受理了 56 项专利，其中发明专利 17 项、实用新型 39 项。根据科技创新情报 SaaS 服务商“智慧芽”发布的《中国大陆半导体封测领域 TOP10 企业专利排行榜—2023 年 1 月更新版》显示，公司专利数量位于中国大陆半导体封测企业中第 6 位。

在产品研发方面，MEMS 封装技术已完成开发，产品已进入量产阶段。成功开发了国内国际领先的 5G 宏基站大功率 GaN 射频功放的塑封封装技术，目前已完成技术路线和方案的评估认证，并最终通过了终端客户的系统性可靠性验证。完成了新产品 TO252、TO220、TO263、TO247、PDFN 等产品设计，都采用了高密度大矩阵集成电路封装技术进行设计。公司将继续扩大该封装技术的产品生产过程使用率。

在生产工艺方面，继续深入的开发高密度大矩阵引线框技术，完成了 TSSOP8(11R)、SOP(12R&15R)、DIP(5R)的引线框开发、开发了软焊料装片工艺和铝线键合工艺。

3、精益生产推动变革

报告期，公司将精益生产和六西格玛管理有机结合，将人、过程和技术集成管理，大力开展降本增效，改善制造技术，通过持续改善来提升产品质量、降低生产成本。生产运营体系进一步培育并丰富公司的改善土壤，建立起以人际关系、组织间关系和员工责任感三者协调统一的改善文化氛围。质量改善、降本增效等改善活动，班组长能力提升、六西格玛等培训项目贯穿全年，公司通过“一次无故障交付”“一次做好”质量和客户服务意识提升，设备自主保全和员工合理化建

议、课题改善等主题改善活动，提高员工改善意识，落实员工提案 288 件，完成课题改善 40 余件。

夯实公司特色精益生产技术，以柔性化的设备和构建面向产品族的生产单元为抓手，提升设备柔性化，提升制造技术，增强生产柔性化、敏捷化。报告期，公司在快速换线、精益物流、单元化流线化、自动化生产方面展开工作，不断的进行工艺路线的改进和优化，不断的进行制造单元设备类型和位置的调整。同时加大了 ME&EAP 开发、智能制造、数字化转型方面的投入，公司全资子公司广东气派荣获“东莞市智能制造示范项目”和“东莞市智能工厂”称号。

4、紧抓产品品质，提升服务质量

报告期，公司围绕质量、交期、服务等方面，以行业标杆企业质量水平为目标，以满足甚至超过客户期望为目标，结合公司实际情况，完善体系和标准化。建立了红线管控机制和客户服务质量管理标准，厘清了客户服务团队架构和职能，稳步提升了产品品质和服务质量。

5、加快人才团队建设，构建人才培养体系

报告期，为持续培养气派科技具有高素质、高潜力、系统训练建设较强综合能力的人才队伍，支持业务部门业绩、关键绩效指标的达成，优化公司人才结构，为公司高速发展提供人才支持。因此逐步完善内部人才梯队建设，重点培养“新生代”核心骨干力量，在原有校招生培养的基础上，重新优化建立“新生力（校招生）”培养体系，在人才培养过程中，我们遵循鼎优原则，将优秀的资源向优秀的人才进行倾斜，帮助、鼓励优秀学员，为他们的成长提供足够的发展空间和成长平台，并且从招聘、培养、任用、评价等各关键要点组建专业团队，给新生力群体制定为期三年的培养计划，分别为磨芯期、铸芯期、创芯期三个阶段，确保培养的人才符合公司、业务、新生力需求。

为推动公司高质量可持续发展，提升中基层班组长的基本素质和管理能力，举办了两期“绩优班组特训”、“班组长品管道场”培训，完成了六西格玛管理方法的导入。

6、持续推进募投项目，为未来产能需求提供保障

报告期，公司持续实施募投项目，为募投项目储备人员，“高密度大矩阵小型化集成电路封装测试扩产项目”的设备基本到位，项目建成后，将新增年封装

产能 16.1 亿只，受集成电路行业周期性波动，项目尚未达产，“研发中心（扩建）建设项目”尚在实施。截止报告期末，“高密度大矩阵小型化集成电路封装测试扩产项目”及“研发中心（扩建）建设项目”已投入募集资金 30,503.84 万元。

7、完善公司治理，保护投资者利益

公司根据证监会、上交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织公司董事、监事、高级管理人员等参与证监局、上市公司协会的培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、上证 E 互动、投资者现场调研及日常电话、邮件等通方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

（二）2023 年董事会重要工作

2022 年，受宏观经济、新型冠状病毒等影响，半导体行业景气度出现周期性下滑，消费市场萎靡不振，半导体产业链出现芯片去库存现象。2023 年，随着新型冠状病毒防控措施优化，宏观经济复苏，半导体行业将出现触底回升，叠加国产半导体的逐渐崛起，半导体产业链的景气度有望快速复苏。

2023 年，公司将认真吸取 2022 年的经验和教训，坚持以“自主创新”为基石，不断在工艺、技术上创新，提升产品品质、节约成本；不断导入新产品、新客户，持续优化公司产品结构、客户结构；加大先进封装的研发投入，努力追赶先进封装技术；坚定信心，稳健经营，以“高质量工作年”的态度奋发前行。

1、创新营销策略，深度挖掘客户

2023 年，公司将突出营销、客户服务的核心地位，进一步完善营销策略。公司将扩大营销团队，打造专业的营销及服务团队，在更多的集成电路设计企业聚集地设立销售驻点，为客户提供更优质的服务。聚焦核心客户，深挖并导入优质的新客户，提升客户服务能力，不断提高市场占有率和优质客户占比进一步加大与知名品牌的战略合作。

2、加强研发投入，发展功率半导体和先进封装

2023 年，公司将持续对功率半导体和先进封装方面投入研发经费，开发更多品类功率半导体封装和先进封装技术，为公司产品丰富提供有力的技术支撑

3、持续深化精益生产

2023 年，公司将继续深化精益生产，通过积极践行“服务、经营和进取”三个意识，推动落实质量竞争力提升、人力成本控制、精益管理及人才培养四条管理主线，优化流程、减少浪费，让“严、细、实”的工作作风落到实处，全员参与、持续改善，让精益生产为企业管理提质增速。

4、加强质量管理体系建设，推动品质红线管理

2023 年，公司将继续完善质量管理体系，深入推进 MES 系统管控，设立品质红线管理思维，坚持以“零缺陷”为目标，为客户提供质量有保证的产品。

5、持续建设人才梯队

2023 年，将遵循“德才兼备、结构合理，能进能出，满足需求”的原则，从战略发展的角度把人才梯队建设视为一项长期的系统工程。公司将聚焦重点岗位和关键环节，积极构建人才梯队，为长远发展补充新鲜血液、储备人力资源。将企业文化融入到人才梯队建设中能够增强员工对企业的认同感，树立员工的主人翁意识。基于企业战略制定人才规划、培养方案。

通过“新生力”的招聘和培养，内部潜力员工的挖掘，为公司选拔后备人才。帮助员工做好职业生涯规划，引导员工结合自身特质和职业目标，制订职业生涯规划，人力资源部按年进行跟踪、指导，促进人力资源需求和员工职业生涯规划需求的平衡，最大限度激发个人潜力。

6、倡导“高质量工作年”，推动公司高质量发展

2023 年，公司倡导“高质量工作年”，树立红线思维，强化“内核”建设，以开拓精神和专业工作态度，不断提高产品和服务质量，实现“量”“质”双升。真抓实干，牢固树立员工的质量意识，夯实基础，推动公司高质量发展。

7、进一步提升公司治理水平，加强信息披露和投资者关系管理

公司董事会将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，继续提升公司治理水平，保护投资者合法权益，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制。

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，

进一步规范信息披露和投资者关系管理工作，保证公司信息披露的内容真实、准确和完整性,不断提高公司信息披露的透明度和及时性，保持公司与投资者关系的良性互动。

气派科技股份有限公司董事会

2023年3月29日